

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20251031

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他：“鼎龙控股集团”微信视频号直播
参与单位名称 及人员姓名	社会公众投资者
时间	2025 年 10 月 30 日晚上 19:00~19:40
地点	“鼎龙控股集团”微信视频号直播，公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	2025 年 10 月 30 日晚上 19:00~19:40：董事会秘书杨平彩女士、投资者关系 总监熊亚威先生
投资者 关系活动 主要内容 介绍	公司介绍： 公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司， 主营业务横跨两大板块一半导体业务板块、打印复印通用耗材业务板块。现 阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板 块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头， 占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导 体先进封装材料等业务。此外，在打印复印通用耗材业务板块，公司全产业 链布局，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游 销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司在该 行业内的竞争优势地位。 公司前三季度业绩表现： 2025 年前三季度，公司实现营业收入 26.98 亿元，同比增长 11.23%， 实现归属于上市公司股东的净利润 5.19 亿元，较上年同期增长 38.02%。其 中，今年第三季度：实现营业收入 9.67 亿元，环比增长 6.49%，同比增长 6.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.08 亿元，环比增长 22.54%，同 比增长 31.48%。 其中：2025 年前三季度，公司半导体板块业务（含半导体材料业务及 集成电路芯片设计 and 应用业务）实现主营业务收入 15.34 亿元（其中芯片业 务收入已剔除内部抵消），同比增长 41.27%，占比提升至 57%水平。公司

	半导体板块业务现已成为驱动公司主营业务收入及净利润双增长的重要动力，到 2025 年年底时，半导体业务的收入占比有望进一步提升。 问 1：公司 CMP 抛光垫的市场规划？ 答：公司在 CMP 抛光垫领域深耕十余年，现已拥有较强的综合竞争优势。在产品布局方面，公司实现了集成电路 CMP 抛光垫的全品类布局，量产各种型号的硬垫、软垫产品，同时还向大硅片用抛光垫、碳化硅为代表的化合物半导体用抛光垫等进行新产品拓展。在市场开拓方面，公司是国内 CMP 抛光垫供应龙头，已经深度渗透国内主流晶圆厂客户，成为了部分客户的第一供应商，同时持续在外资晶圆厂客户进行市场推广。在供应链管理方面，公司已全面实现 CMP 抛光硬垫核心原材料的自主制备，产品的综合竞争力持续增强。 问 2：公司 CMP 抛光垫的产能利用率？ 答：在武汉本部，公司拥有月产 4 万片左右（即年产约 50 万片）的抛光硬垫产线，随着今年 CMP 抛光垫销售收入的增长，其产能利用率持续提升。公司为未来产品销售持续拓展做好产能储备，预计至 2026 年一季度末将其产能提升至月产 5 万片左右（即年产约 60 万片）。 问 3：公司的核心产品增长趋势如何？ 答：公司核心产品如 CMP 抛光垫、抛光液、清洗液及柔性显示材料在 2025 年前三季度同比增长均接近或超过 50%。下游半导体与 OLED 显示面板行业景气度较高，客户产能利用率维持高位。下游厂商的不断扩产，有望带动上游原材料的需求。公司认为自身产品放量得益于两方面：一是行业整体需求上升带来的增量；二是公司在材料端的产品布局优化及与客户新产品线同步验证能力的增强，共同推动了高增长。 问 4：公司布局了哪些抛光液产品？ 答：在抛光液领域，公司进行了全品类抛光液产品型号的布局，拥有 CMP 抛光液核心原材料——研磨粒子的自主供应优势，也具备从研磨粒子开始定制化开发 CMP 抛光液产品的能力。目前，公司已有介电材料、多晶硅、氮化硅、金属栅极、铜制程抛光液等多类 CMP 抛光液产品在客户端批量供应，同时各类抛光液产品搭载自产研磨粒子的供应链优势明显；搭载自产氧化铈磨料的抛光液等新产品在客户端导入验证流程按计划推进。 问 5：公司临时键合胶进展情况？ 答：临时键合胶方面，公司在已有客户持续规模出货中。此外，公司持续关注并推动重点产品在国内各主流封测厂客户的验证导入情况，进一步开拓新的重点客户群体，努力打开新的业绩增长空间及产品布局拓展机会。 问 6：公司下游客户拓展了哪些？
--	--

	答：公司的下游客户主要围绕其两大核心业务板块。作为公司当前发展重点和增长引擎的半导体新材料业务，客户高度集中于国内领先的集成电路制造厂商和显示面板制造厂商。具体而言，其半导体工艺材料（如 CMP 抛光垫、抛光液）主要销售给各大晶圆厂，柔性显示材料主要供应给 OLED 面板厂。在传统的打印复印耗材领域，其客户是全球范围内众多专业的兼容耗材生产商与经销商，业务覆盖面广且分散。 问 7：公司研发费用投入的方向？ 答：2025 年前三季度研发投入金额 3.89 亿元，较上年同期增长 16%，占营业收入的比例为 14.41%，其中大部分投向半导体板块如柔性显示材料、抛光液与清洗液、抛光垫和光刻胶。展望未来，公司将在保持一定体量研发投入的同时，适度控制研发费用占收入比重，趋于平缓下降。公司将审慎评估研发资源的有效性、投入产出比及新项目的必要性，确保资金高效利用。
附件清单	无
日期	2025 年 10 月 30 日